

2011年3月期 決算説明会

2011年5月2日

東京エレクトロン デバイス株式会社



東京エレクトロン デバイス株式会社

決算報告

東日本大震災の影響について

【被害の状況】

◆ 人的被害状況

軽傷者1名を除き全員無事

◆ 事務所等の被害状況

仙台、郡山、水戸、宇都宮、つくば 営業停止

4月4日から通常業務再開

【業績への影響】

特別損失：30百万円

義援金：10百万円

2011年3月期 連結業績

(単位:百万円)

	2010年3月期		2011年3月期		増減率 (%)
		百分比%		百分比%	
売上高	85,145	100.0	91,315	100.0	7.2
売上総利益	14,473	17.0	16,168	17.7	11.7
営業利益	2,079	2.4	2,745	3.0	32.0
経常利益	2,117	2.5	2,941	3.2	38.9
当期純利益	1,166	1.4	1,918	2.1	64.5
1株当たり当期純利益	11,000.86円		18,095.67円		
R O E	5.4%		8.5%		
1株当たり年間配当金	5,000円		6,600円		
期末従業員数	844人		880人		

2011年3月期 連結資産

(単位:百万円)

科目	2010年3月期	2011年3月期	増減額
現預金	1,621	1,373	▲248
受取手形・売掛金	20,890	21,025	134
たな卸資産	15,636	19,347	3,710
その他流動資産	2,987	3,505	517
有形固定資産	1,121	1,469	347
無形固定資産	464	390	▲74
投資その他の資産	2,925	3,143	218
資産計	45,649	50,254	4,605

2011年3月期 連結負債・純資産

(単位:百万円)

科目	2010年3月期	2011年3月期	増減額
買掛金	7,255	7,360	105
短期借入金	5,105	7,996	2,890
その他流動負債	6,177	5,923	▲253
固定負債	5,198	5,753	554
負債計	23,737	27,034	3,296
資本金	2,495	2,495	—
資本剰余金	5,645	5,645	—
利益剰余金	13,903	15,238	1,335
その他包括利益累計額	▲132	▲158	▲25
純資産計	21,911	23,220	1,309
負債・純資産計	45,649	50,254	4,605

2011年3月期 連結キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

	2010年3月期	2011年3月期	増減額
営業キャッシュ・フロー	▲225	▲1,877	▲1,651
投資キャッシュ・フロー	▲100	▲676	▲576
財務キャッシュ・フロー	703	2,321	1,617
現金及び現金同等物 期末残高	1,621	1,373	▲248

セグメント別 連結売上高・利益

(単位:百万円)

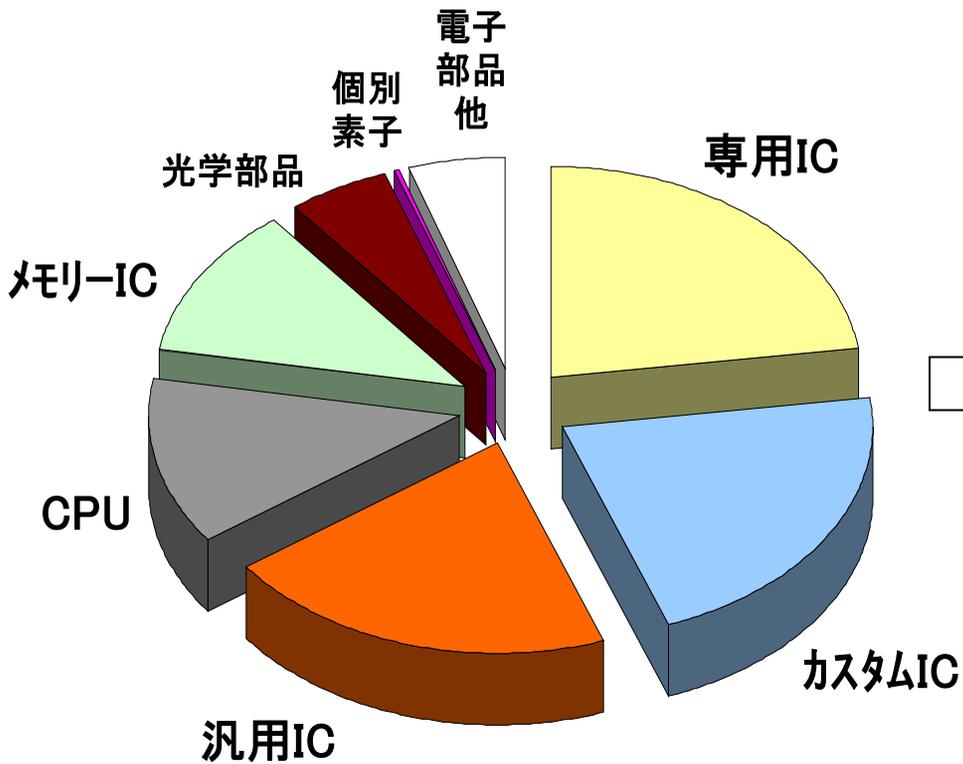
セグメント	2010年3月期		2011年3月期			
	売上高	セグメント利益	売上高	増減率 (%)	セグメント利益	増減率 (%)
半導体及び電子デバイス事業	67,439	905	73,354	8.8	2,089	130.6
コンピュータシステム関連事業	17,706	1,211	17,961	1.4	852	▲29.6
合 計	85,145	2,117	91,315	7.2	2,941	38.9

半導体及び電子デバイス事業

品目別 売上構成

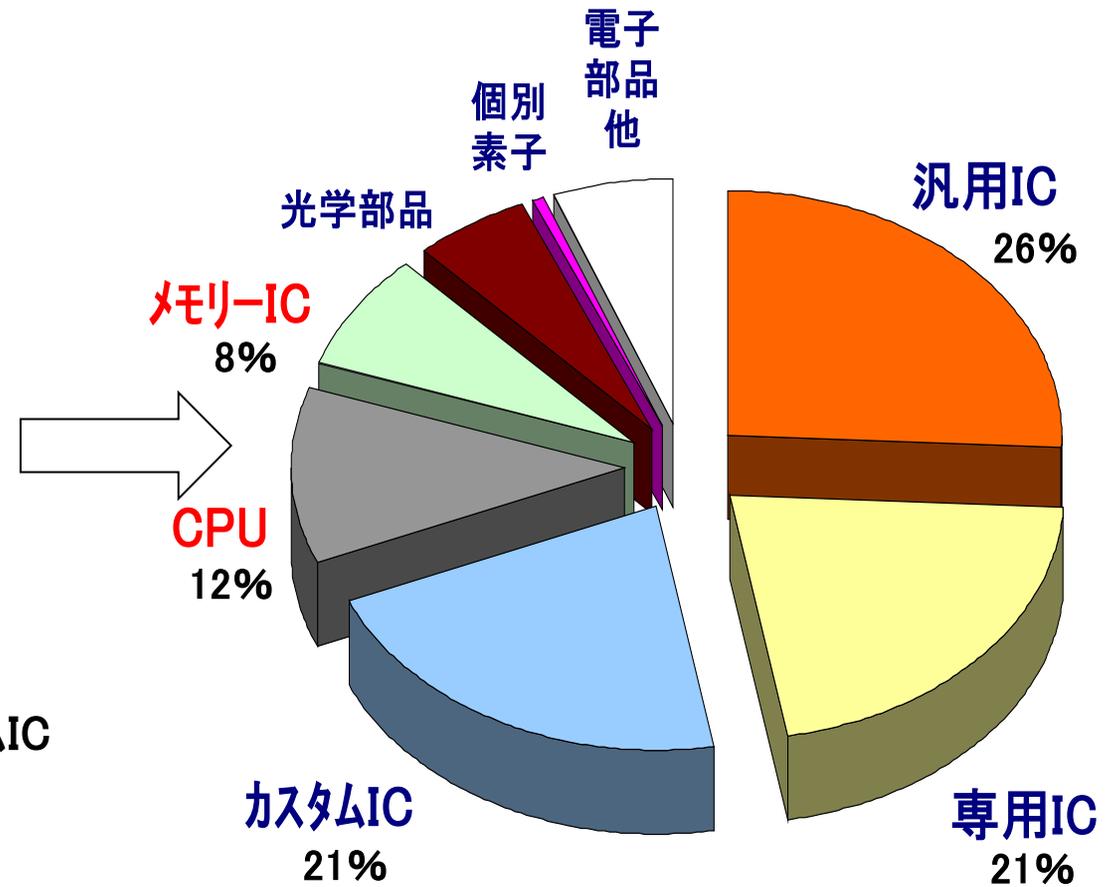
＜2010年3月期 内訳＞

売上高：67,439百万円



＜2011年3月期 内訳＞

売上高：73,354百万円



* 品目についての説明は、P.31～ P.33をご参照ください。

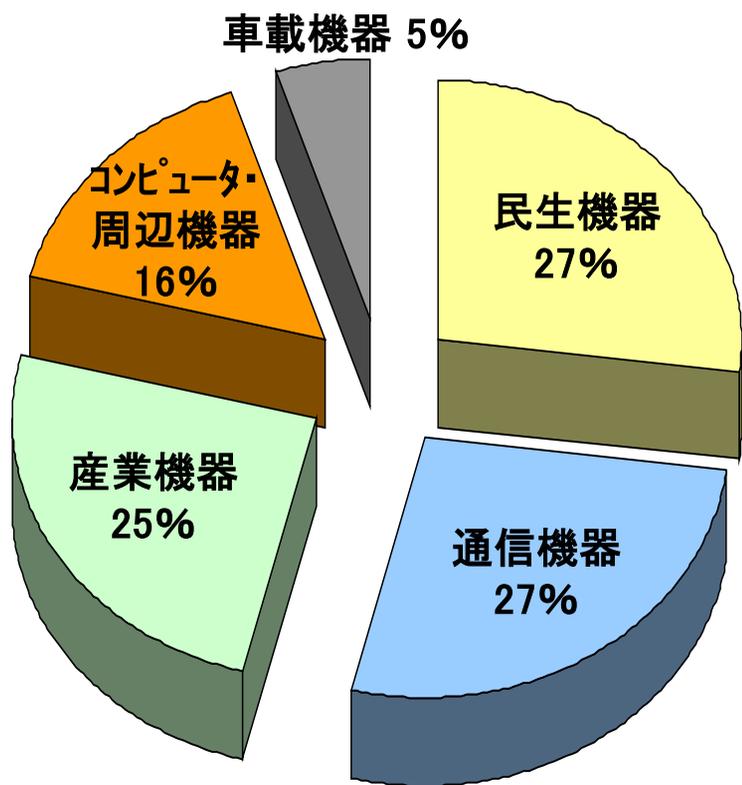
半導体及び電子デバイス事業
主な品目別 売上増減

品目	主な仕入先	対前年増減率	主な要因
汎用IC	リニアテクノロジー、TI	36%	産業機器向けを中心に大幅増加
専用IC	ビクシシステムズ、ピクセルワークス、富士通、シリコンイメージ	2%	AVアンプ、デジタル家電向け増加、基地局向け減少
カスタムIC	ザイリンクス、富士通	8%	医療機器など産業機器向け増加、基地局向けは減少
CPU	フリースケール、TI	▲0.1%	複合プリンター向け増加、デジタル家電向け減少
メモリーIC	スパンション、IDT	▲27%	携帯電話、デジタル家電向け減少

注)社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

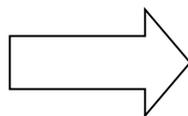
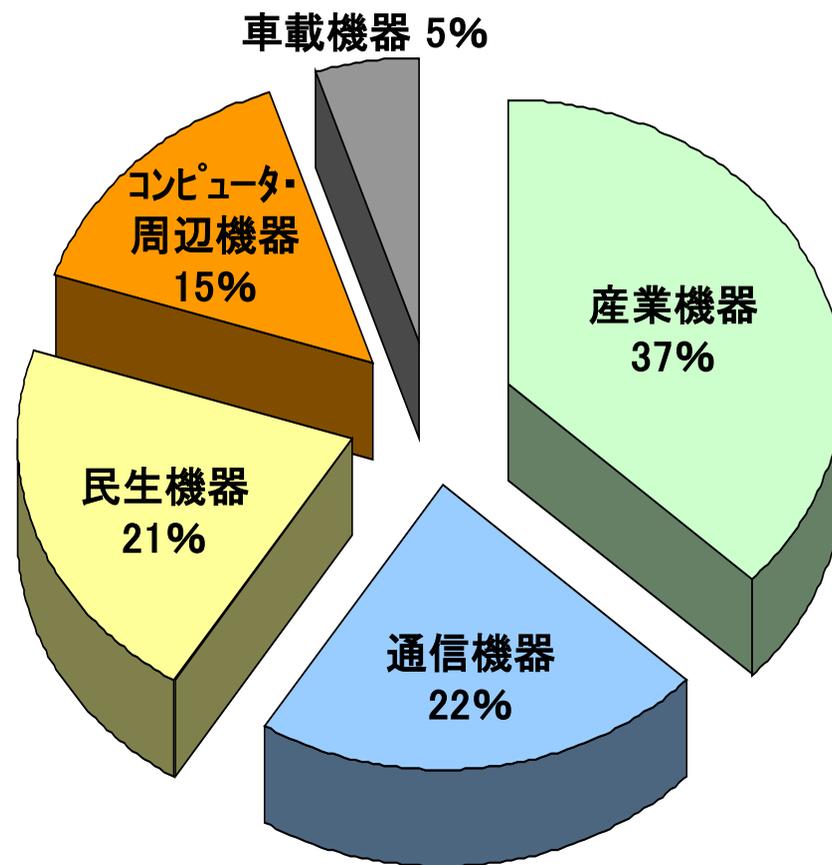
＜2010年3月期 内訳＞

売上高：67,439百万円



＜2011年3月期 内訳＞

売上高：73,354百万円



用途別 傾向

用途	主なアプリケーション	当社の傾向
産業機器	医療機器、放送機器、テスター、半導体製造装置、ロボット、計測器	設備投資回復に伴い 産業機器全分野好調、急回復 汎用IC、カスタムIC増
通信機器	基地局、ルーター、伝送装置、携帯電話	商権移管の影響で基地局低調、カスタムIC減 携帯電話も低調、メモリーIC減
民生機器	デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、薄型TV、AV機器	エコポイント終了に伴い下期低調、CPU減、メモリーIC減
コンピュータ・周辺機器	複合プリンター、液晶プロジェクタ、PC及び付属機器	複合プリンターは堅調
車載機器	カーナビゲーション、カーオーディオ	カーナビゲーションは横ばい

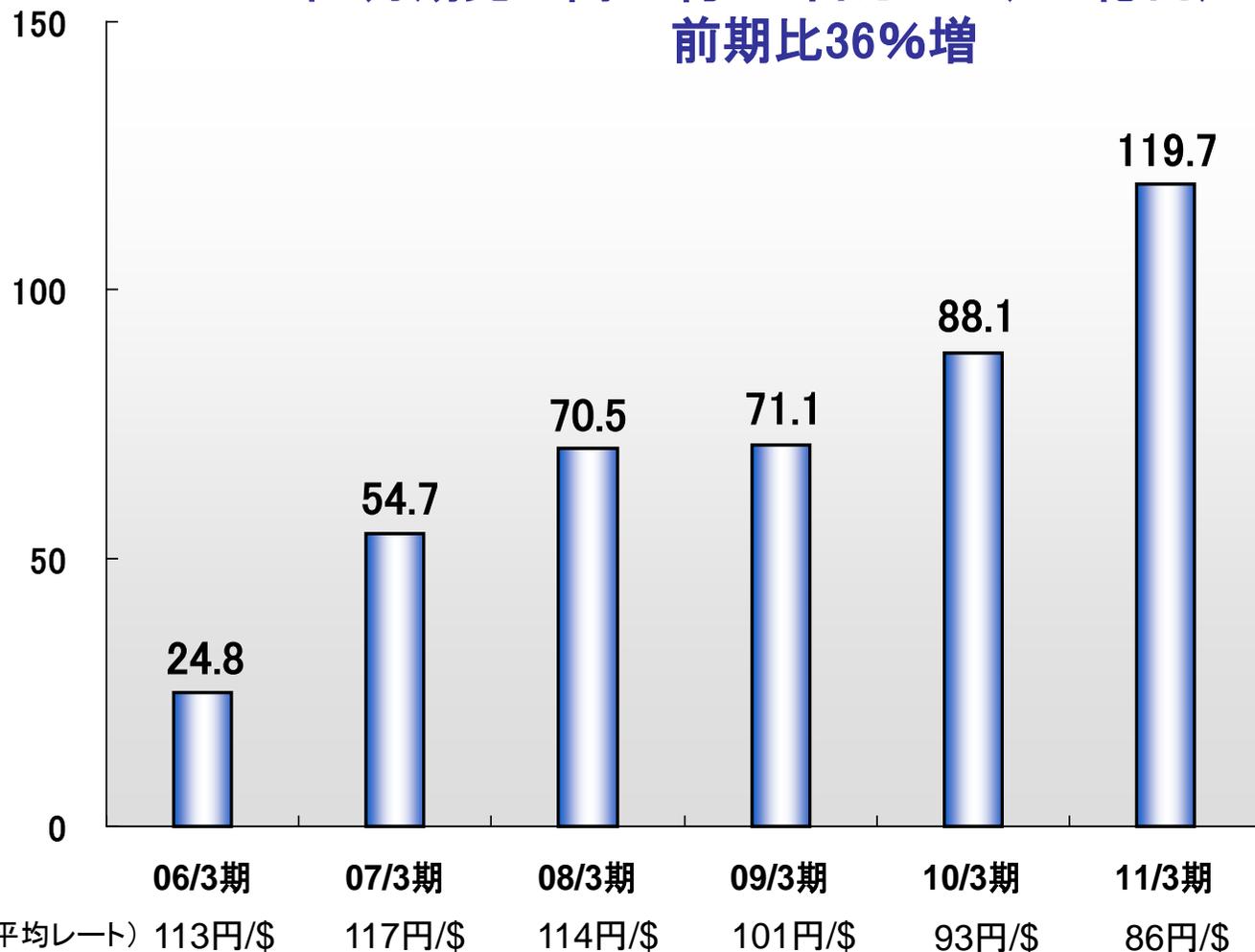
[海外子会社 売上高推移]

[営業拠点]

(US\$M)

2011年3月期売上高：約120百万ドル(102億円)
前期比36%増

2010年12月：マレーシア開設



開発ビジネスについて

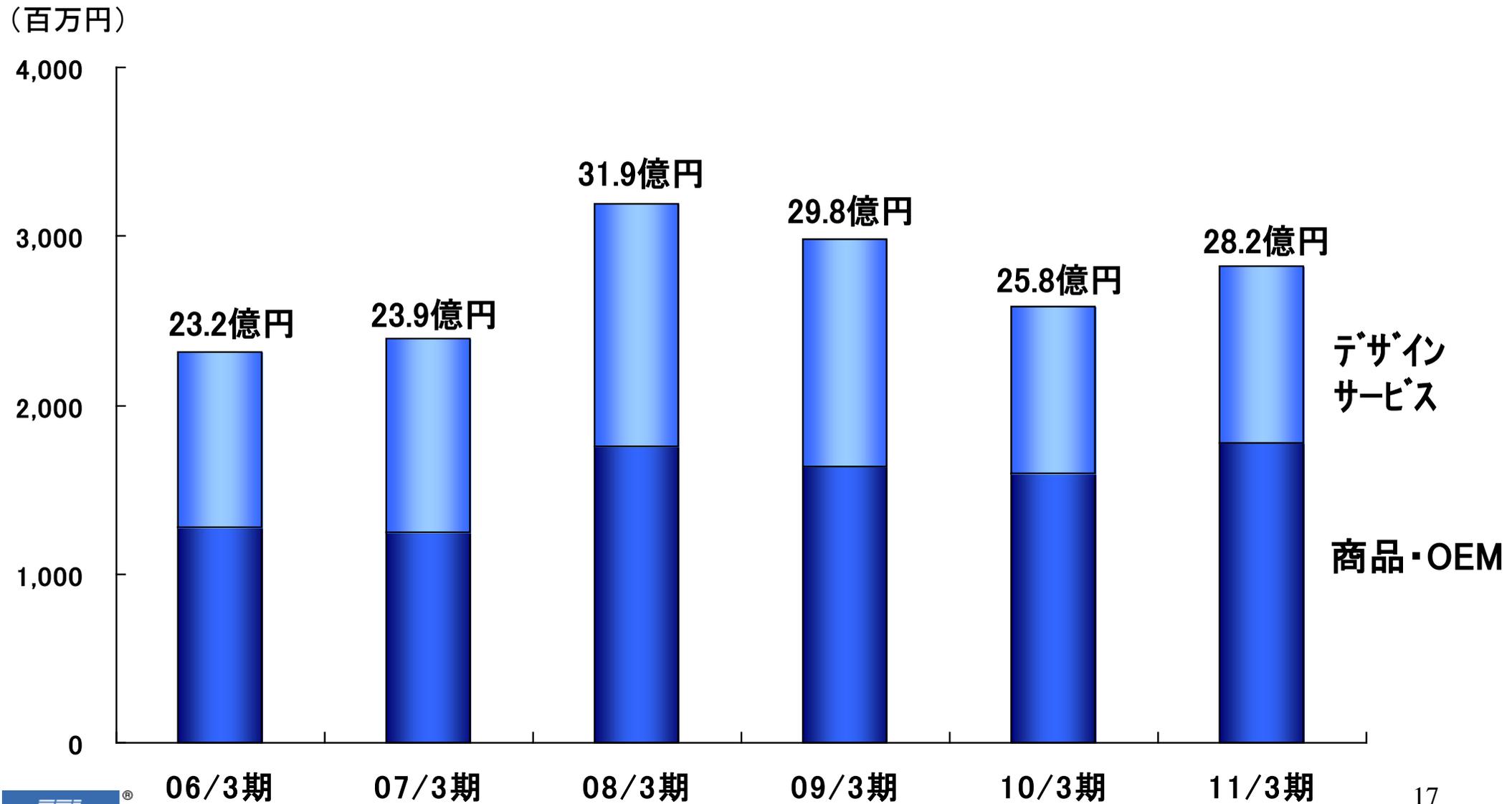
inrevium

(インレビウム)

◆ メーカー機能への取り組み



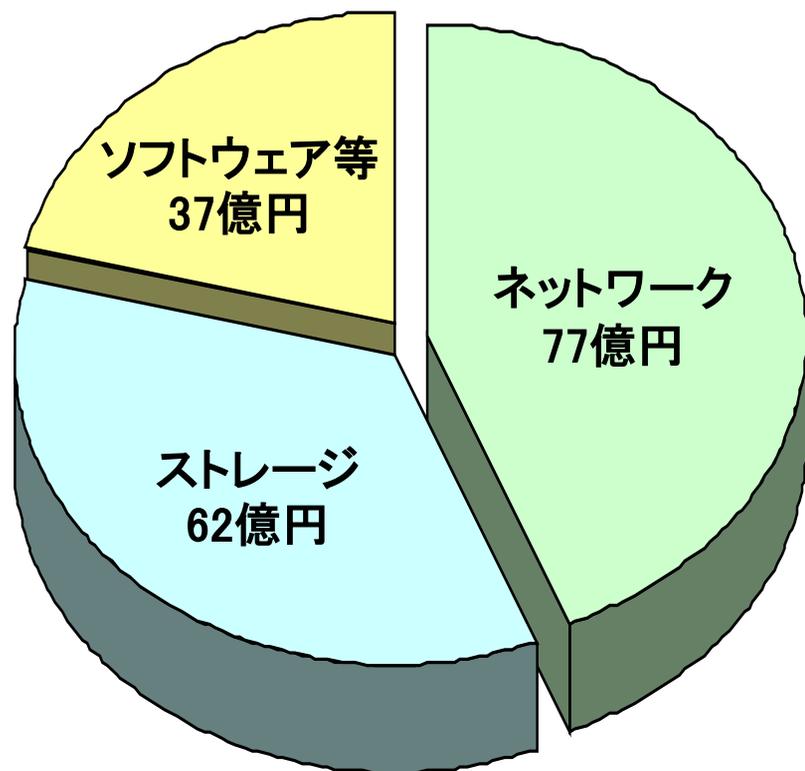
インビーム売上高推移



コンピュータシステム関連事業

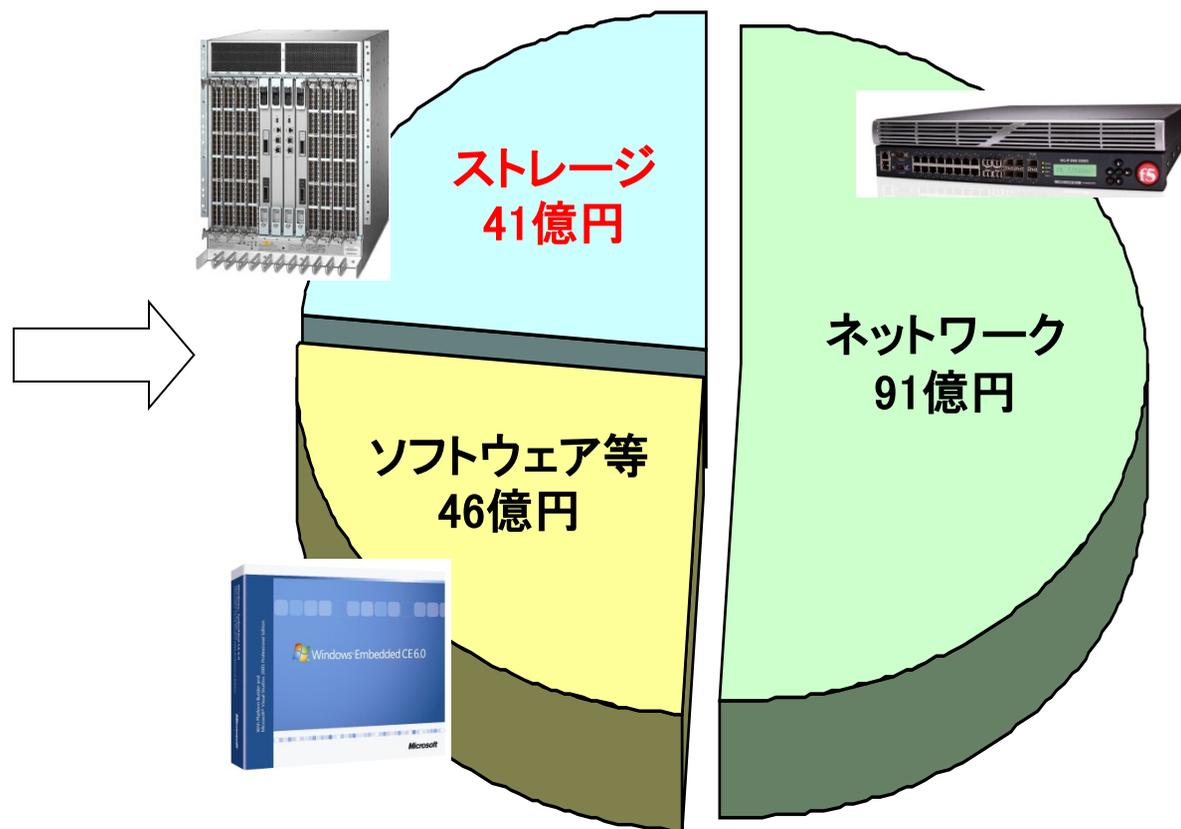
＜2010年3月期 内訳＞

売上高：17,706百万円



＜2011年3月期 内訳＞

売上高：17,961百万円



品目別 売上増減要因

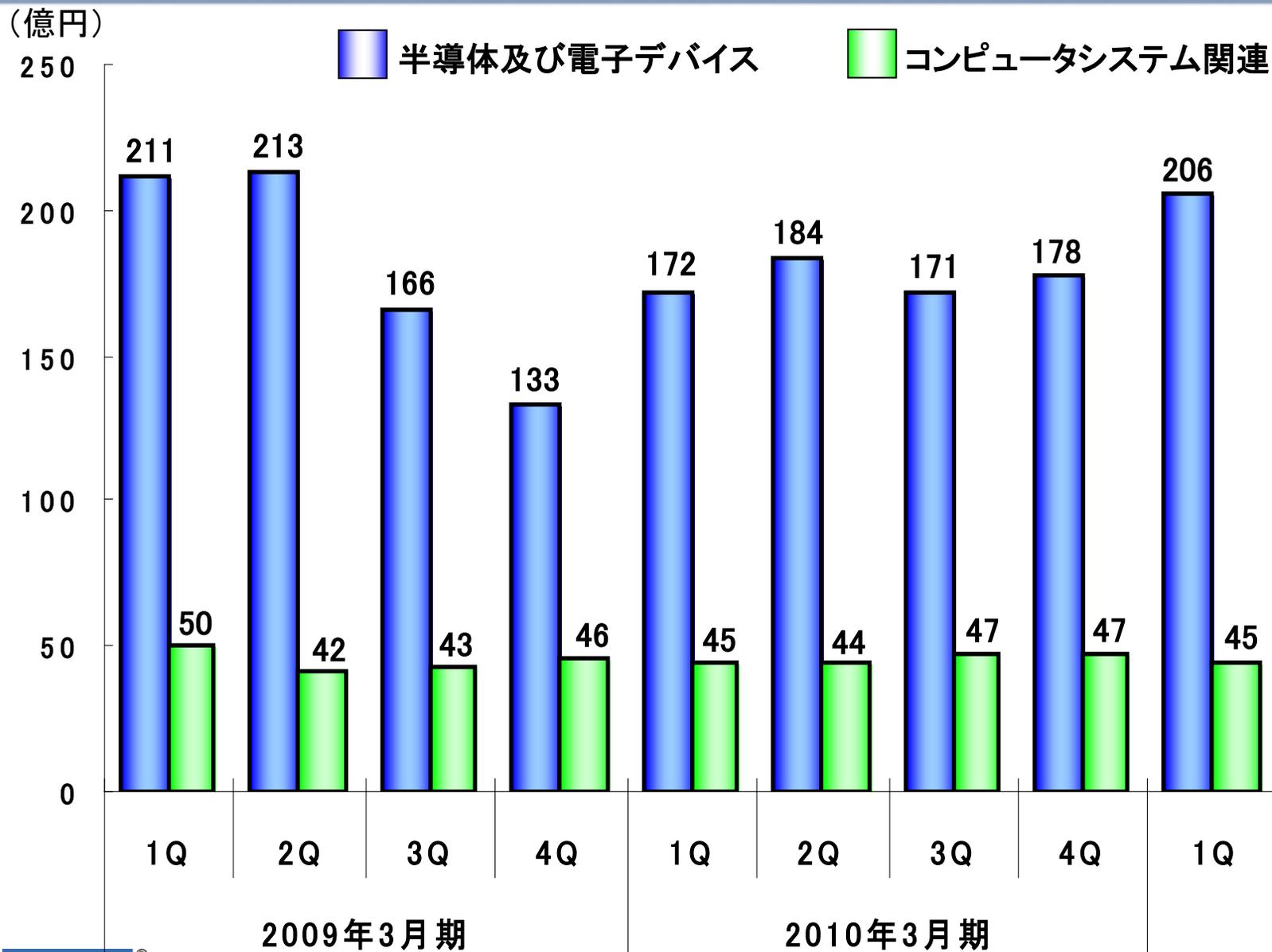
品目	主な仕入先	対前年増減率	主な要因
ネットワーク関連	F5ネットワークス	18%	製品販売伸長、保守堅調
ソフトウェア	マイクロソフト	24%	POS端末向けソフトウェア増加
ストレージ関連	ブロード	▲33%	商流の変更により減少

注)社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

2012年3月期

- ・ 業績見込み
- ・ 経営テーマ
- ・ 配当方針

受注高推移



【半導体及び電子デバイス事業】

半導体市場は、震災により供給面の影響あり
上期不透明、下期回復を想定

【コンピュータシステム関連事業】

国内IT投資は、引き続き低調
上期抑制傾向、下期からの回復を想定

セグメント別 連結売上高見込み

(単位:百万円)

セグメント	2011年3月期 実績		2012年3月期 見込み		対前年 増減率 (%)
	売上高	構成比 (%)	売上高	構成比 (%)	
半導体及び電子デバイス事業	73,354	80.3	75,800	79.8	3.3
コンピュータシステム関連事業	17,961	19.7	19,200	20.2	6.9
合 計	91,315	100.0	95,000	100.0	4.0

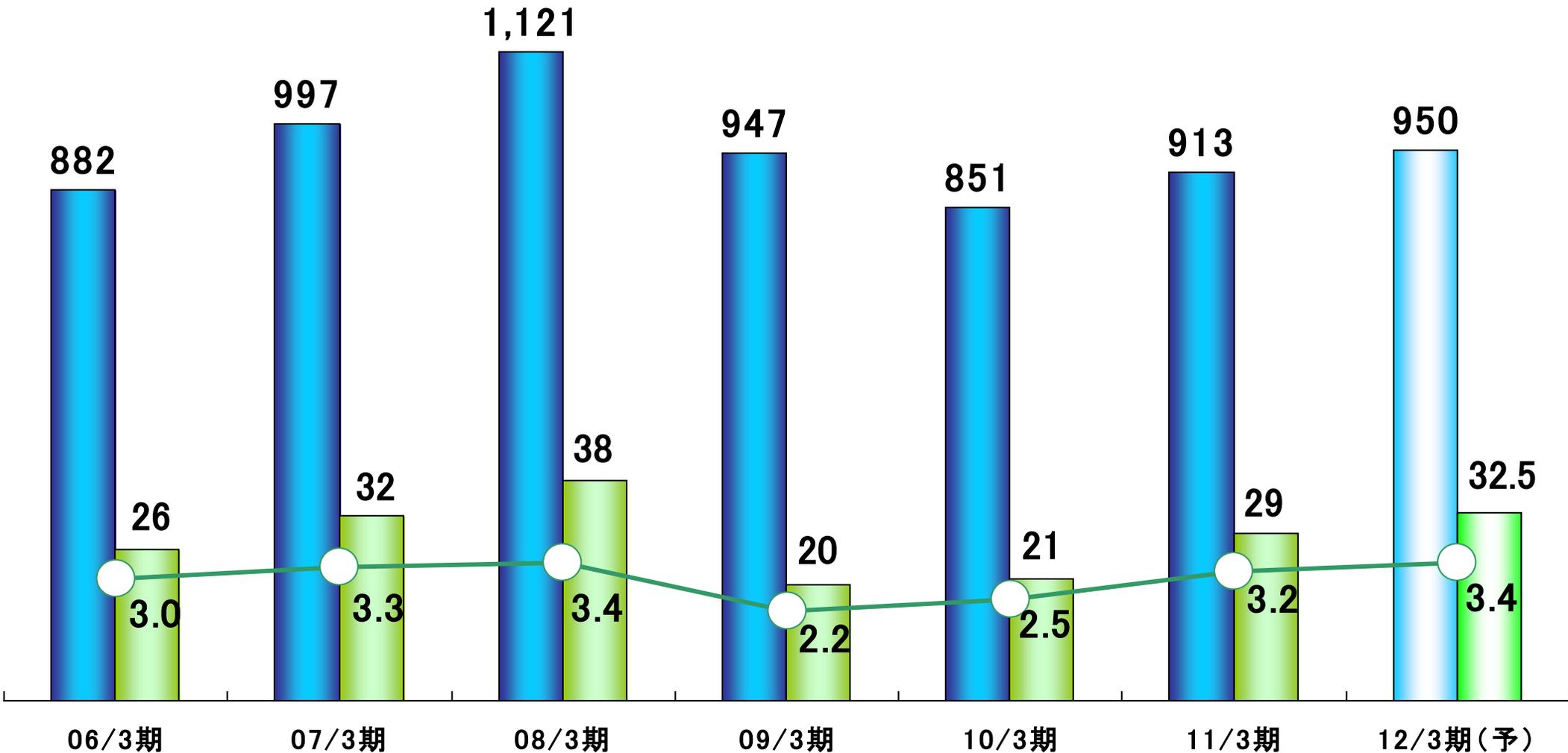
2012年3月期 連結業績予想

(単位:百万円)

	2011年3月期	2012年3月期			対前年 増減率 (%)
	通期実績	上期予想	下期予想	通期予想	
売上高	91,315	44,000	51,000	95,000	4.0
営業利益	2,745	1,145	2,225	3,370	22.7
経常利益	2,941	1,100	2,150	3,250	10.5
当期純利益	1,918	630	1,320	1,950	1.7

業績推移及び計画

■ 売上高(億円) ■ 経常利益(億円) ○ 経常利益率(%)



今期特に力を入れる経営テーマ(1)

■次世代を担う商材と人材の創出

- 次世代人材の登用と育成
- 半導体: プロダクト企画の機能を強化
新商材の研究やビジネス戦略を部門横断で協議・決定
- 半導体: 大口顧客様直結の部を設置
顧客密着の一層の強化と一元的な損益管理
- 半導体: 設計・開発能力の一層の向上
FPGAの技術で事業を牽引、自社製品の企画拡販を目指す
- コンピュータシステム: 取り扱い製品の選択と集中
直接販売の強化、組み込み製品の拡大

今期特に力を入れる経営テーマ(2)

■海外事業の一層の促進

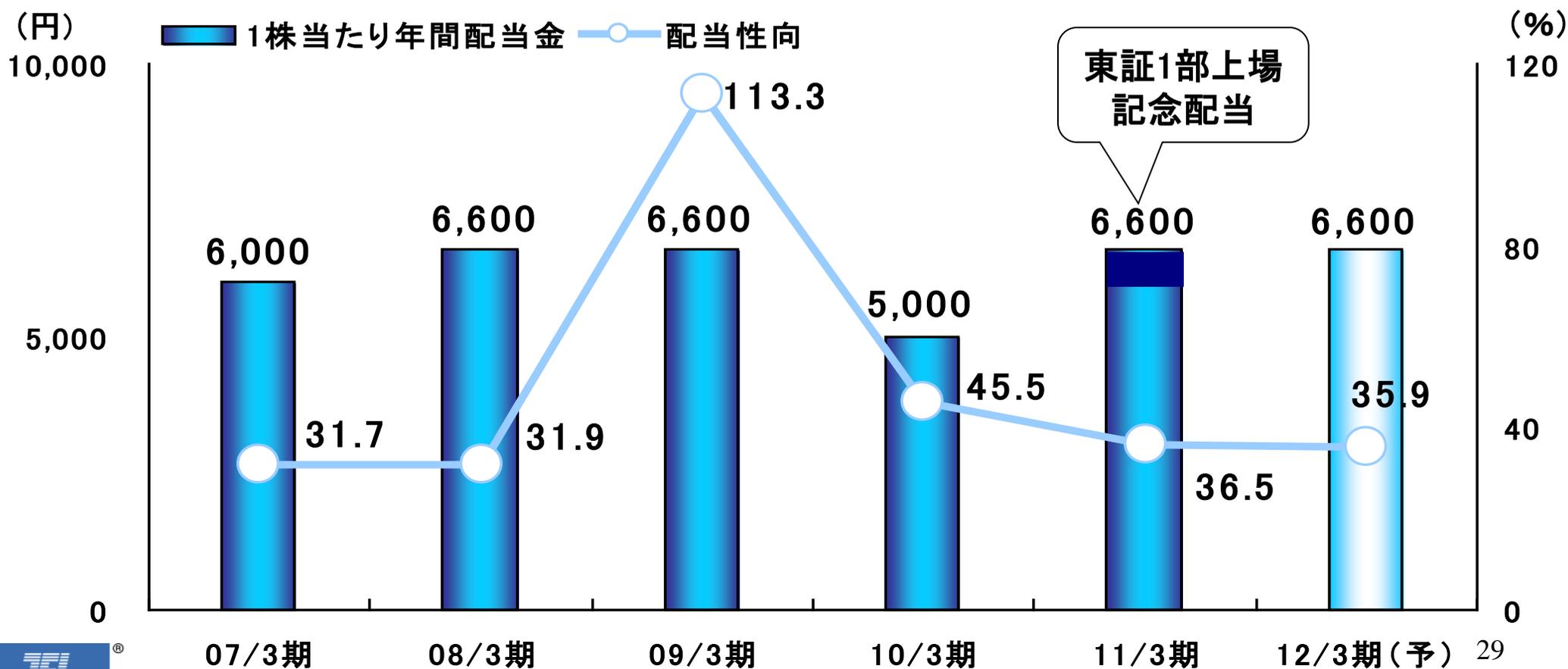
- TED香港を海外本社とするアジア組織体制への変更と強化
- 現地企業の開拓および販売促進
- 本社の役員を配置

■新事業部門

- グリーンプロダクト推進部を新事業推進部へ改称、幅広い商材の取り込みを図る
- オンラインビジネス「e-Line」をさらに活性化し、新商材の販促ツールとしても活用する

配当方針

- ◆ 継続的かつ安定的な配当の実施を基本として、業績を反映した適正な利益還元を原則
- ◆ 当面の配当性向水準：連結当期純利益の35%程度を目安



資料取り扱い上の注意

このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。

当社の参画するエレクトロニクス業界及びIT業界は変化のスピードが大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがって、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。

また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。

◆本資料に関するお問い合わせ先

東京エレクトロン デバイス株式会社 広報・IR室 秋永

TEL 045-443-4000

セグメント・品目		主な仕入先名
半導体及び 電子デバイス事業	汎用IC	リニアテクノロジー社、オン・セミコンダクター社、TI 社
	専用IC	カビウム・ネットワークス社、コネクサントシステムズ社、富士通セミコンダクター(株)、インターシル社、ピクセルワークス社、シリコンイメージ社、ビクシスシステムズ社、ザ・リンク・セミコンダクター社、インビアム
	カスタムIC	富士通セミコンダクター(株)、ザ・リンクス社、インビアム
	CPU	フリースケール・セミコンダクタ社、富士通セミコンダクター(株)、TI 社
	メモリーIC	IDT社、ラムトロンインターナショナル社、富士通エレクトロニクス(株)(スパンション)
	光学部品	アバゴ・テクノロジー社
	個別素子	オン・セミコンダクター社
	電子部品他	コーセル(株)、インビアム
コンピュータシステム 関連事業	ネットワーク機器	エクストリームネットワークス社、F5ネットワークス社
	ソフトウェア	マイクロソフト社、オラクル社
	ストレージ関連	ブロードコム社、エミュレックス社

【半導体及び電子デバイス事業】

品目	主な取扱商品	機能
汎用IC	汎用リニアIC(アナログIC) 汎用ロジックIC	色々な用途に共通に使用されるIC
専用IC	画像処理用IC 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用IC
カスタムIC	ASIC、PLD	お客様の仕様に応じて作られる固有IC
CPU	マイクロプロセッサ、DSP	電子機器の頭脳、演算機能・制御機能
メモリーIC	SRAM、フラッシュメモリ	記憶用IC、書込み、読出しが可能なものや読出しのみのものがある
光学部品	発光ダイオード、フォトカプラ	電気を光に変換して使用する電子部品
個別素子	整流素子、トランジスタ	増幅、整流などの機能を持つ部品
電子部品他	ボード、電源、コネクタ	プリント配線基板上にIC、電源、コネクタなどの部品を実装した製品(ボード)

【コンピュータシステム関連事業】

ネットワーク関連		インターネット接続機器(負荷分散、セキュリティ) 企業向けネットワークシステム構築機器。
ソフトウェア等		セキュリティ用ログ長期保存・分析ミドルウェア 企業向け産業機器に組み込まれるマイクロソフト社のソフトウェア。
ストレージ関連		SAN(ストレージエリアネットワーク)スイッチ、 SAN接続機器、ストレージセキュリティ機器など。